

研究简报

用图像识别的方法检测集成电路的键合点

卢朝阳,周辛妮,顾英

西安电子科技大学综合业务网国家重点实验室,西安;西安电子科技大学微电子所,西安

收稿日期 1997-9-25 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

关键词 [IC芯片](#) [键合区及键合点](#) [图像分割](#) [形状分析](#)

分类号

Methods for Inspection of IC Pads and Bonds Using Image Recognition

LU Zhaoyang, ZHOU Xingni, GU Ying

National Key Lab.of Theory and Chief Technology of Integrated Services Networks
XIDIAN University, Xi'an; Institute of Microelectronics, XIDIAN University, Xi'an

Abstract

Key words [IC wafer](#) [bond pads](#) [image segmentation](#) [shape analysis](#)

DOI:

通讯作者

作者个人主页 卢朝阳;周辛妮;顾英

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(341KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“IC芯片”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [卢朝阳](#)

· [周辛妮](#)

· [顾英](#)